

EMIシールドペースト〈スプレータイプ〉

半導体PKGやプラスチック筐体の表面に直接塗布！

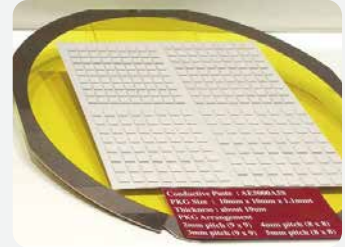
用途

半導体PKG向けシールド用途

スプレー塗布機を使用し、表面に塗布。その後硬化させることで、半導体PKG表面に10 μ m程度のシールド層を形成します。機器の軽薄短小化への対応が可能。



塗布・硬化後イメージ



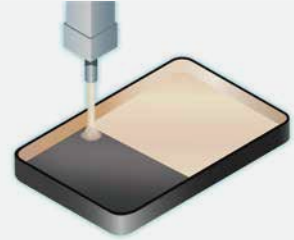
塗布・硬化後イメージ

筐体シールド用途

スプレー塗布機やスプレーガンを使用し、エレクトロニクス製品のプラスチック筐体に塗布。硬化後、シールド層を形成します。



塗布・硬化後イメージ



スプレー塗布イメージ

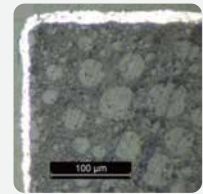
特徴

- 70dBを超える**優れたシールド特性**
- 様々な基材への**高密着性**

PKG 塗布表面



クロスセクション



ラインナップ&特性

製品型番		AE5000A5-12GS	AE5000Wシリーズ<代表値を記載>		AE5000L-73
タイプ		PKGシールド高密着タイプ	PKGシールド薄膜タイプ		筐体シールドタイプ
粘度	E型 10rpm※	mPa・s	200±100		
硬化条件	予備硬化	100℃×10分			—
	本硬化	170℃×50分	150℃×50分	80℃×120分 / 100℃×60分	
体積抵抗率[代表値]		$\Omega \cdot \text{cm}$	5.0E-05	2.0E-05	1.0E-04

※ コーンプレート型粘度計 CP-40 10rpm

